

Produktbeschreibung

FINISH: DIESER VORSTAND WIRD IMMERSION GOLD BEZAHLEN NACH IPC-6012.
DICKE WIRD .050uM ÜBER 3-6uM NICKEL.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KANN NICHT VERPACKT WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite
Schichtstruktur

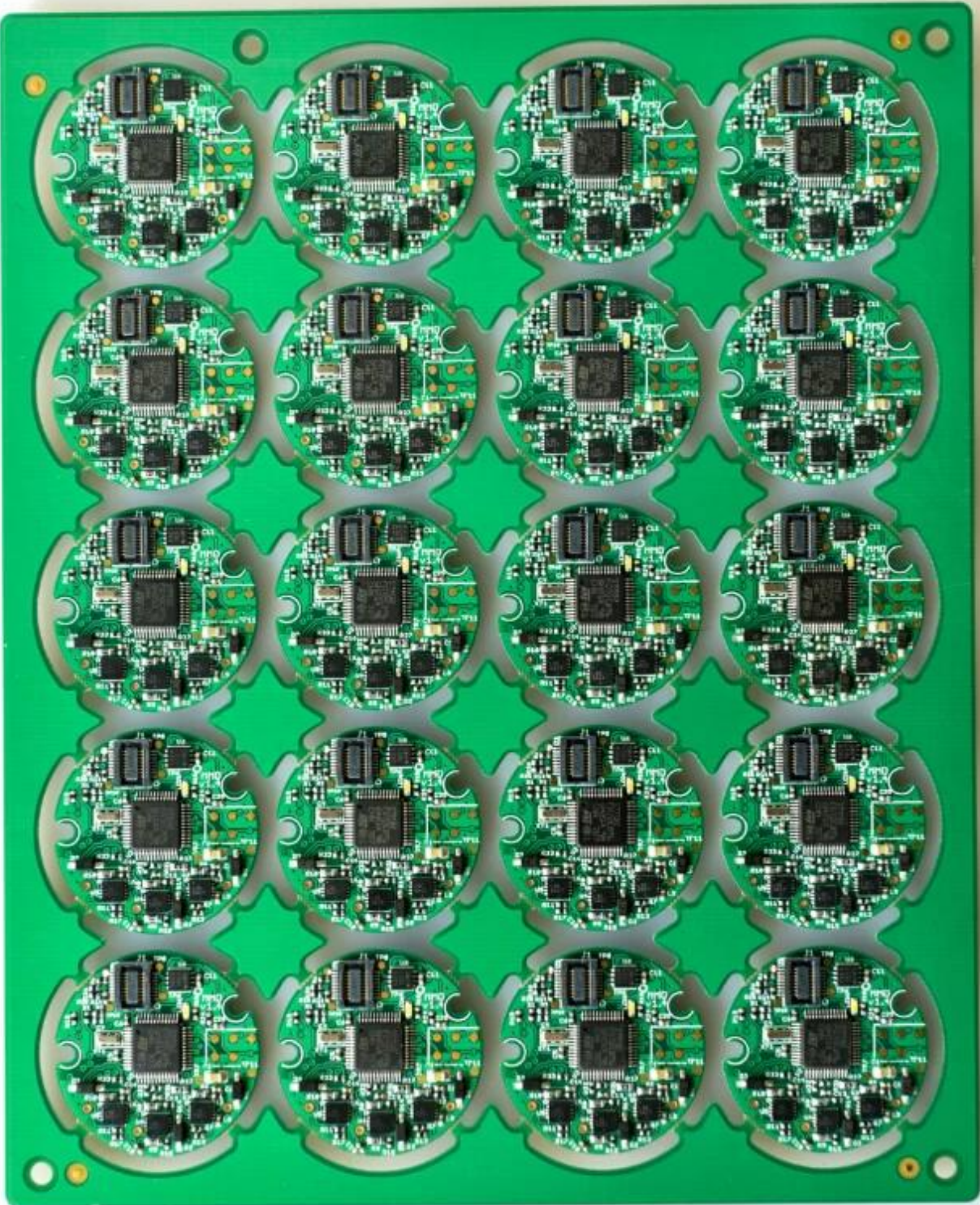
L1 ----- HOZ
- PP 7mil -
--
L2 ----- 1OZ
- CORE 9.05mil -
L3 ----- 1OZ
--
- PP 7mil -
L4 ----- HOZ

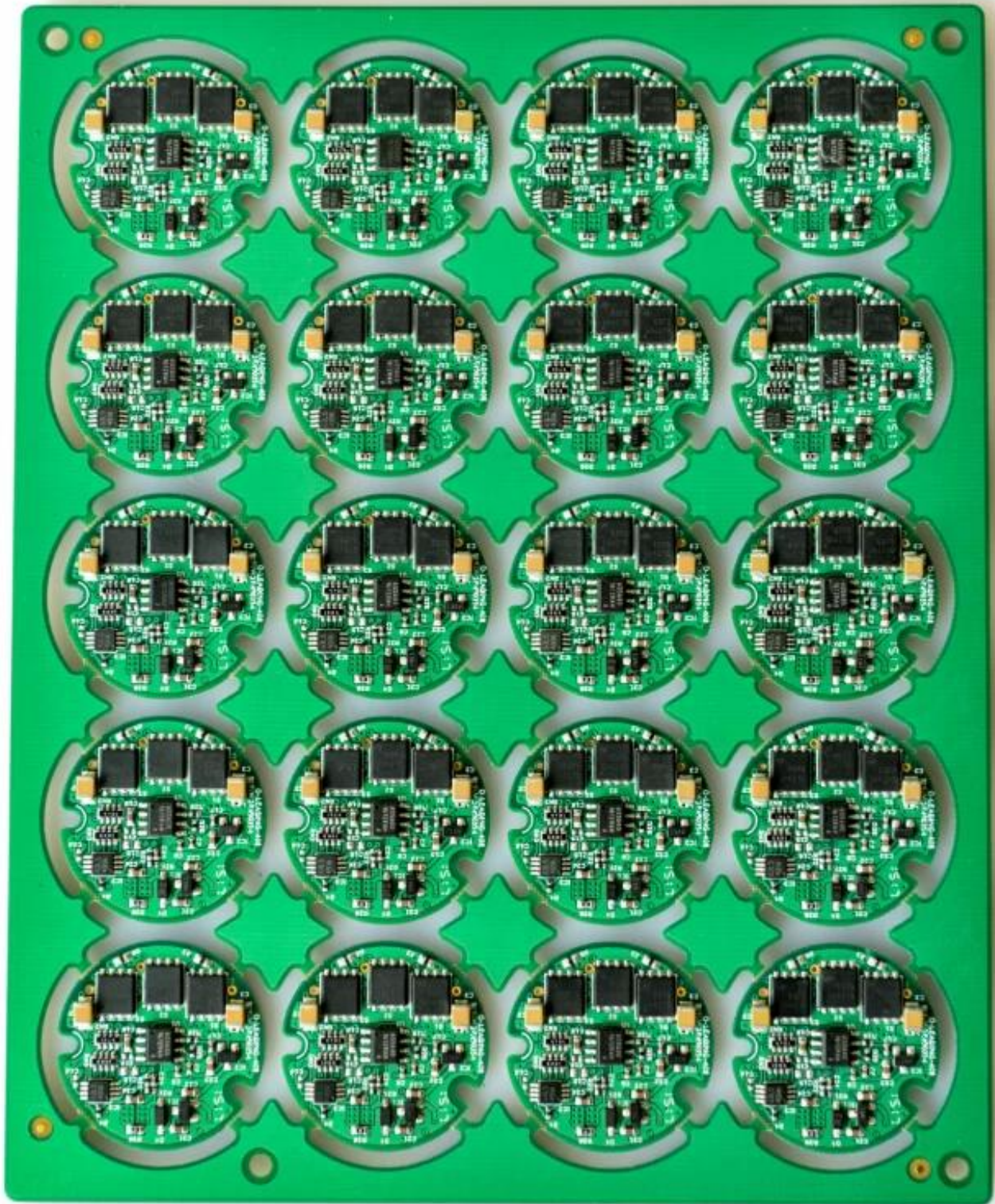
Layer-Definitionen:

- * .GCMT - Top Conformal Coating Maske
- * .GTP - Top Lötpaste
- * .GTO - Top Siebdruck
- * .GTS - Top Soldermaske
- * .GTL - Obere Schicht
-
- * .G2L - Innere Signalschicht 1
- =====
- * .G3L - Innere Signalschicht 2
-
- * .GBL - Untere Ebene
- * .GBS - Unterseite Lötmaske
- * .GBO - Unterseite Siebdruck
- * .GBP - Unterseite Lötpaste
- * .GCMB - Bottom Conformal Coating Maske









[Leiterplatten-Hersteller, Leiterplatten-Design in China](#)